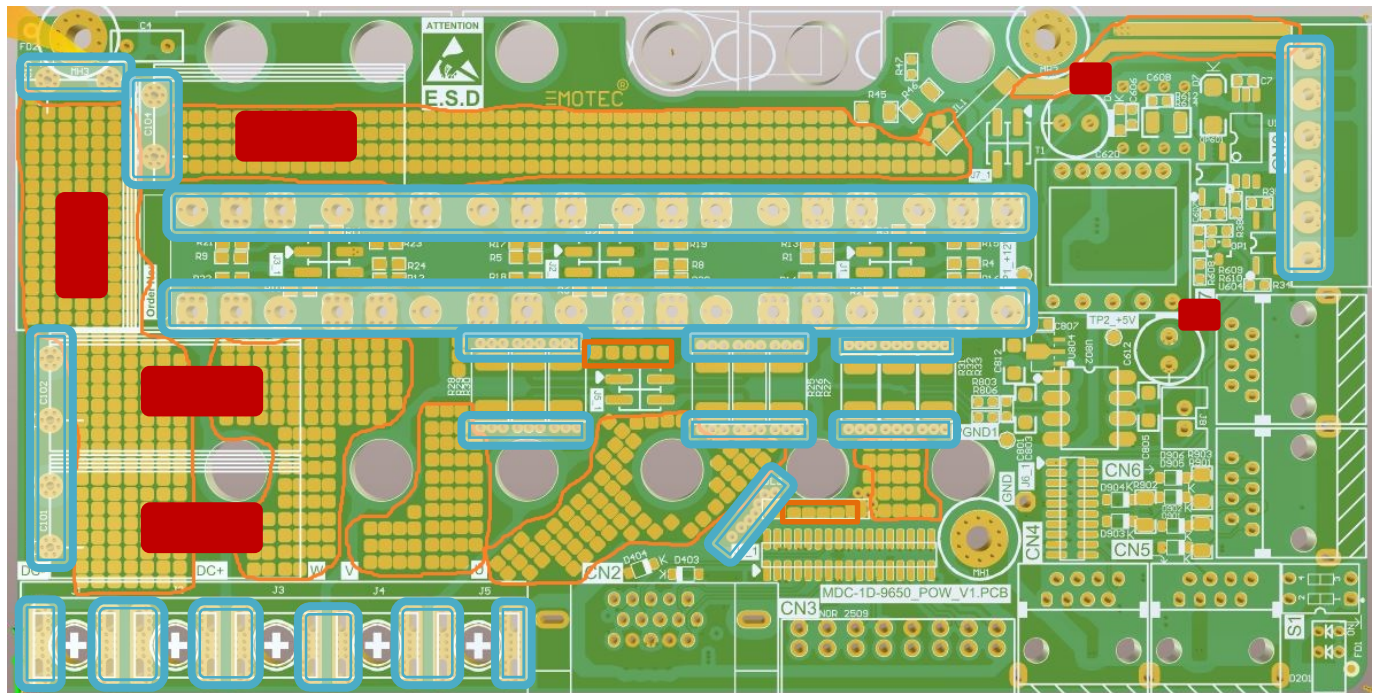


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	MDC-1D-9650_POW_V1.0	焊接	QM033250920	V1	1/2	20250920



1. 加锡位置

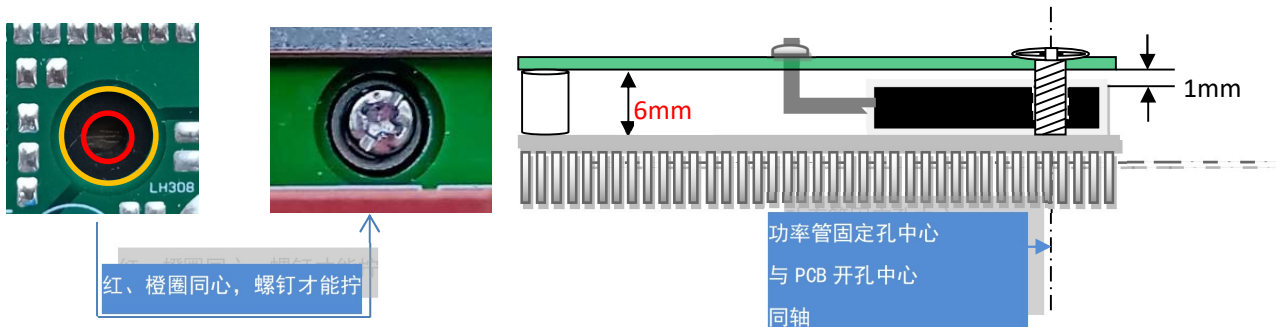
顶层



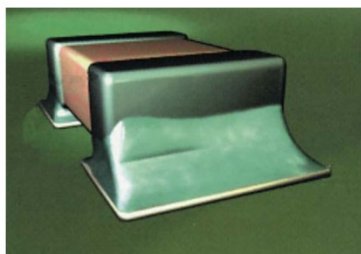
PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	MDC-1D-9650_POW_V1.0	焊接	QM033250920	V1	2/2	20250920

2. 焊接基本要求

- 1) 功率管 Q1~Q12 共计 12 个 (T0-247 封装的管子)，管脚**直角折弯**，
- a) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 **6mm** 焊接；且要求功率管脚顶层和底层**双面焊接**；
- b) 焊接后，功率管固定孔  红色圈中心与 PCB 开孔  橙色圈中心同轴；



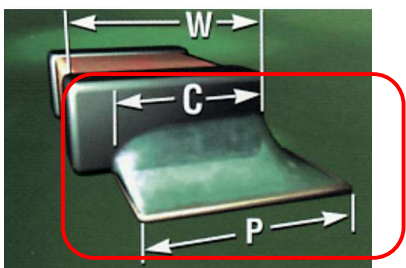
- 2) 电阻 R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33 要求焊接完成后，元件的电极与相应焊盘位置对正，即元件无移位



目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度，取两者中的较小者。

- 可接受:** a) 端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 5% (约 0.15mm，下图为焊接不良图片)。
- b) 端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿



备注：该位置要求 100%目检，不符合要求的，拒收

- 3) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 4) 所有极性元件，严禁方向反；
- 5) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 6) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 7) 手工操作要做防静电处理；
- 8) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 9) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	